

# ClayTec HFA dünn

Art. 09.009 D = 8 mm

- **Ökologische Holzfaserausbauplatte (HFA)**
- **Lehmputz-Trägerlage im Holzbau**
- **Dünn und preisgünstig**



Dünne Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger auf Holz- und Holzwerkstoffen. Die Platten können geschraubt oder geklammert werden. So entsteht auf Holz sehr einfach ein sicherer Untergrund für die Armierungslage aus Lehmklebe- und Armiermörtel und das nachfolgende Lehm-Finish. Ergänzend zu diesem Produktblatt gilt der **ClayTec Leitfaden ökologische Trockenbauwände im System**.

 **ClayTec**<sup>®</sup>

**DEUTSCHLAND**  
© ClayTec GmbH & Co. KG  
Nettetalter Straße 113-117  
D-41751 Viersen-Boisheim  
+49 (0)2153 918-0  
service@claytec.com  
claytec.de

**ÖSTERREICH**  
© ClayTec Lehmbaumstoffe GmbH  
Stranach 6  
A-9842 Mörttschach  
+43 (0) 676 430 45 94  
info@claytec.com  
claytec.at

Ausgabe 2026/05  
Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten. Aktuelle Version  
unter [claytec.de](https://www.claytec.de)

# ClayTec HFA dünn

## Art. 09.009 D = 8 mm

**Anwendungsgebiet** Holzfaserausbauplatte (HFA) als Putzträger im Holzbau für ClayTec Lehmputze im Innenbereich. Zum vollflächigen Bekleiden von Massivholzbauteilen, Schalungen und Holzwerkstoffplatten. Auf Flächen der Wassereinwirkungsklasse WO-I nach DIN 18534-1, z. B. in Bädern (außer Duschbereiche) und häuslichen Küchen. Mit Armierungslage Untergrund für YOSIMA Lehm-Designputz oder ClayTec Lehm-Oberputz fein 06 mit ClayTec Lehmfarbe verarbeitungsfertig oder dem ClayFix Lehm-Anstrichsystem.

**Zusammensetzung** Holzfasern aus Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Forsten.

**Baustoffwerte** Druckfestigkeit  $\geq 100$  kPa, Rohdichte  $230 \text{ kg/m}^3$ , Wärmeleitfähigkeit-Wert  $0,05 \text{ W/mK}$ ,  $\mu 5$ . Wärmespeicherung:  $C_p 2,1 \text{ kJ/kgK}$ ,  $3,9 \text{ kJ/m}^2\text{K}$ . Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: E

**Maße** D = 8 mm, L = 1.200 m, B = 600 m. Fläche pro Platte =  $0,72 \text{ m}^2$ .

**Lieferform** 276 Platten/EW-Pal.

**Lagerung** Im Lager liegend auf Paletten, trocken. Die Lagerung ist unbegrenzt möglich. Beim Transport und Lagerung auf der Baustelle vor Nässe schützen. Auf der Baustelle liegend und eben lagern auf trockenen Paletten oder Hölzern. Kanten vor Beschädigungen schützen.

**Luftfeuchtigkeit** Feuchtebeanspruchungen aus nass eingebauten Putzen und Estrichen nicht zulässig. Allgemein darf die relative Luftfeuchte bei Lagerung und nach dem Einbau 70 % nicht übersteigen.

**Materialbedarf** Bei der Ermittlung des Materialbedarfs Reserve von ca. 10 % für Verschnitt etc. berücksichtigen.

**Untergrund** Der Untergrund muss tragfähig, frostfrei, trocken, sauber (Holzwerkstoffplatten staubfrei), frei von Salzbelastung, ausreichend rau und saugfähig sein. Fehlstellen grob ausbessern. Sandene Untergründe ggf. mit ClayTec Tiefengrund und Festiger fixieren.

Der Feuchtegehalt von Bekleidungs-Untergründen aus Massivholzbauteilen, Schalungen und Holzwerkstoffplatten ist wegen möglicher Trocknungsverformungen und nachfolgenden Schäden an Bekleidungen und Beschichtungen zu kontrollieren.

**Verarbeitung** Die Platten werden mit der Stichsäge, der Kreissäge oder mit dem Cuttermesser geschnitten.

Die unterste Plattereihe wird mit etwas Abstand („Luft“) zum Boden eingebaut.

Auf Holz oder Holzwerkstoffen flächige Befestigung mit Schrauben (ClayTec Lehmbauplattenschrauben im Abstand von 200 mm), in der Regel aber Klammerbefestigung mit Klammern 25 mm, z. B. haubold Klammern Serie KG 700 (ETA-Zulassung), Abstand der Klammern ca. 150 mm, Randabstand 25 mm (von Mitte Klammer). Die Klammern sind Oberflächen-bündig einzutreiben, sie dürfen nicht versenkt werden. Holzwerkstoffplatten sollen nicht von den Schrauben oder Klammern durchstoßen werden.

Kreuzfugen und die Fortführung von Wandöffnungsbegrenzungen durch horizontale oder vertikale Fugen sind unzulässig. Die Verarbeitung der Platten erfolgt mit um mind. 20 cm, besser 30 cm versetzten vertikalen Stößen.

**Weiterbehandlung** Für die Fugen- und Beschichtungsarbeiten darf die Raumtemperatur etwa  $+10 \text{ °C}$  nicht unterschreiten. Grundsätzlich ist der Feuchteintrag durch den Verputz ist so niedrig wie möglich zu halten. Die wandumlaufende Plattenfuge wird mit ClayTec Lehm-Fugenfüller geschlossen.

Platten sorgfältig entstauben. Spalte  $\geq 1$  mm Breite in voller Querschnitttiefe mit feinem Lehmörtel füllen, trocknen lassen.

**Dünnlagenbeschichtung:** Schraublöcher und Fehlstellen vorab schließen. Nach Trocknung Flächen 3 mm dick mit Lehmklebe- und Armiermörtel überziehen (auch mit der Putzmaschine, Mörtelruhezeiten sind dann nicht notwendig). In die noch nasse Oberfläche wird Glasgewebe 112 flächig eingearbeitet. Nach Trocknung YOSIMA Lehm-Designputz fachgerecht mit geriebener Oberfläche ausführen (geglättete Ausführung nicht möglich). Alternativ Armierlage fertig für den Anstrich ausführen (frisch-in-frisch Überzug D = 1 mm) oder nach Trocknung mit Lehm-Oberputz fein 06 oder Lehmfüll- und Flächenspachtel (Q3) überziehen, Anstrich mit ClayTec Lehmfarbe verarbeitungsfertig oder dem ClayFix Lehm-Astrichsystem.

**Dicklagenbeschichtung:** Flächen mit der Grundierung DIE ROTE vorbehandeln. Lehm-Unterputz mit Stroh, Lehmputz Mineral 20 oder SanReMo in einer Lagen-dicke max. 8 mm auf Wandflächen und max. 5 mm auf Decken- oder Dachschrägenflächen auftragen. In die noch nasse Oberfläche Glasgewebe 112 flächig einarbeiten. Trocknen lassen. Gesamtputzaufbaudicke Wand max. 15 mm, Decken- oder Dachschrägen max. 10 mm, jeweils mind. zweilagig).

**Wandflächenheizung:** Vorbereiten der Flächen mit der Grundierung DIE ROTE oder per Zahnpachtelung. Trocknen lassen. Vorspritz bis max. 8 mm mit einem der o.g. Lehmputzmörtel. Nach Trocknung Auffüttern bis Rohrscheitel Wandheizung. Trocknung des gesamten Unterputzes mit Heizungsunterstützung möglich. Weiteres siehe ClayTec Arbeitsblatt Lehmputze.

Auf Schnittflächen kann in selten Fällen Lignin durchschlagen, die Bereiche können mit handelsüblichen Mitteln gesperrt werden.

Ergänzend zu diesem Produktblatt gilt der **ClayTec Leitfaden ökologische Trockenbauwände im System**.

**Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, sind ausgeschlossen.**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 2026/05.